

**いわて半導体関連人材育成施設（仮称）に係る物品（半導体製造装置）購入
企画提案コンペ実施要領**

1 趣旨

本物品購入は、当センターが整備を進める「いわて半導体関連人材育成施設（仮称）」に設置する半導体製造装置について、教育用設備として、製造現場で稼働する装置と同様の装置を導入することにより、半導体関連産業が求める装置エンジニアの育成、次世代を担う人材の育成、及び地域における半導体関連産業の認知度向上等の推進を図ることを目的に実施するものである。

2 物品名

ドライエッチング装置

3 仕様等

別紙のとおり

4 予算額

36,300,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

※ 装置本体のほか、輸送、配線、調整などの費用を含む。

5 応募方法

(1) 提出書類

- ① 企画コンペ参加申込書（様式1）
- ② 提案内容書（様式は任意。仕様詳細、外観写真は必ず記載すること。） 6部
- ③ 見積書（積算内訳を具体的に記載すること。）
- ④ 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書（様式2）

(2) 提出期限

令和7年1月27日（月）17時 必着

(3) 提出方法

郵送又は持参による

(4) 提出先

公益財団法人いわて産業振興センター ものづくり振興部

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡 2-4-26

TEL : 019-631-3822 / E-mail : h-shimomura@joho-iwate.co.jp

6 受託候補者の選定

(1) 選定方法

提出書類について、当センター内に設置された選定委員会により審査を行い、最も優れた提案を選定する。

(2) 選定基準

項目		主な審査の観点
装置の仕様等	仕様	・ 要求仕様を満たしているか。
	状態	・ 外観上の不備はないか。 ・ 取得時から現在までの保管状況は適切か。 ・ 納品までにどのような整備を実施するか。
	見積価格	・ 仕様や状態等に対する価格は妥当なものと言えるか（価格根拠がきちんと説明されているか）。
提案者の技術力等	基礎技術力	・ 装置の知見を有する技術者が確保できているか。 ・ 装置運用に際してサポート等は充実しているか。
	部品供給力	・ 代替パーツの入手経路は確立されているか。 ・ 供給可能なパーツの対応範囲は十分と言えるか。
	メンテナンス対応力	・ 自社や関連会社における設備は整っているか。 ・ 不調発生時等において迅速な対応が行えるか。
	実施体制	・ 経営基盤が安定しており、納品の確実な履行が期待できるか。 ・ 納品に係る業務体制の構築や工程計画がきちんと成されているか。 ・ 類似案件の実績、納品に係る知識やノウハウ等を有しているか。

(3) 結果の通知

選考結果は、採否を問わず、応募者全員に文書により通知する。

7 その他

- (1) 提出書類は返却しない。
- (2) 企画提案コンペ参加に要する経費は、すべて応募者が負担する。
- (3) 企画提案書に記載された事項は、契約時の仕様書として扱うものとする。ただし、補正事項がある場合には、当センターと契約候補者との協議により、契約締結段階において項目を追加、変更又は削除を行うことができるものとする。